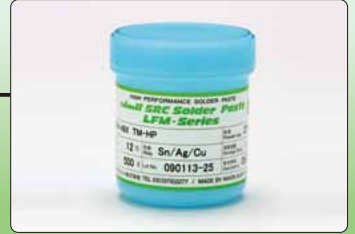


ソルダペースト

連続印刷性、フラックス飛散、プリヒートの高温化など
従来の鉛フリーペーストの問題をあらゆる点から改善しました。

TM-HP

Sn-Ag-Cu系



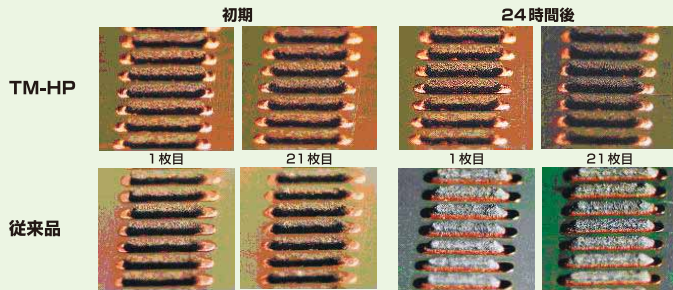
- ① 連続印刷性が良好。経時変化による粘度上昇を最小限に抑え、安定した供給が可能です。
- ② フラックスの耐熱性が向上。極小ランドにおける未融解、はんだボールの発生を防ぎます。
- ③ フラックスの信頼性が高く、無洗浄でも安心して使用できます。

【適用例】 携帯電話、パソコン、PDP、DVD など。

連続印刷性試験 (比較)

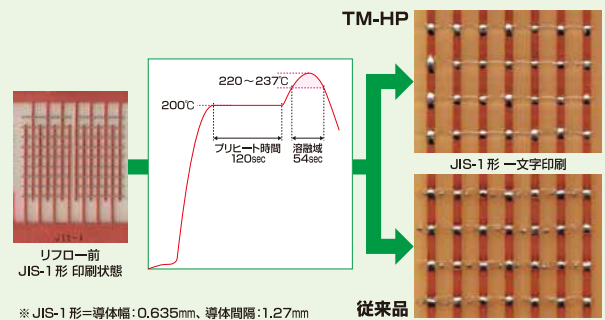
【条件】 8時間×3日間(計24時間)のローリング試験後、21枚の連続印刷性試験を行ない、従来品と印刷形状を比較する。

○印刷 スキージ:ウレタン(硬度90)/スキージ速度:25mm/sec/マスク:ニッケルアディティブ(t=125μm)/基板:ガラエポ片面/印圧:1kgf/cm²/版離れ速度:1mm/sec等速



高温プリヒート試験 (比較)

【条件】 200℃/120secの高温プリヒート(エアフロー炉)でリフローを行ない、TM-HPと従来品で一文字印刷における溶融後の状態を比較する。



TM-TS

Sn-Ag-Cu系

ヌレ性、高温プリヒートでのヌレ、ボール性能が良好。ポイドが少なく、セルフアライメント効果も絶大。

【適用例】
一般的なPbフリーソルダペースト。
ピーク温度230℃以上推奨。

TM

Sn-Ag-Cu系

拡がり性に優れた、ロングライフタイプ。セルフアライメント効果も絶大。

【適用例】
一般的なPbフリーソルダペースト。
ピーク温度230℃以上推奨。

SPM

Sn-Ag-Cu系

携帯電話機メーカーとの共同開発製品。従来ペーストに比べフラックスの飛散が激減。

【適用例】
一般的なPbフリーソルダペースト。
ピーク温度230℃以上推奨。
金フラッシュ基板の接点周辺のはんだ付けなど。

MHS-32

Sn-Zn-Bi系

保管・使用時の経時変化を大幅に改善。RMAタイプでありながらヌレ性も良好。

【適用例】
低融点Pbフリーソルダペースト。
ピーク温度210~220℃でリフロー可能。

IBL

Sn-Ag-Bi-In系

連続印刷時の経時変化を最小限に抑制。弱耐熱基板での鉛フリー化に最適。

【適用例】
低融点Pbフリーソルダペースト。
プロジェクター、ハンディターミナルなど。

INP

Sn-Ag-Bi-In系

印刷・マウント環境下での経時変化問題を解決。チップ立ちが少なく、リード先端のヌレ性も良好。

【適用例】
低融点Pbフリーソルダペースト。
ピーク温度210~220℃でリフロー可能。

A75

Sn-Bi系

Sn-Bi系ソルダペーストで問題となる微小はんだボールを低減。

【適用例】
特殊低融点Pbフリーソルダペースト。
カメラモジュールなど。

ソルダペースト品名構成

(例) LFM-48 W TM-HP
合金名 + 粉末サイズ + フラックス名

ソルダペースト製品仕様

フラックス名	合金名(合金組成)	粉末サイズ	フラックス含有量	溶融温度
TM-HP	LFM-48 (Sn-3.0Ag-0.5Cu)	U, X, W	12.0%	217-220℃
	LFM-14 (Sn-3.5Ag-0.7Cu)			217-218℃
TM-TS	LFM-48 (Sn-3.0Ag-0.5Cu)	X, W	11.5%	217-220℃
	LFM-14 (Sn-3.5Ag-0.7Cu)			217-218℃
TM	LFM-48 (Sn-3.0Ag-0.5Cu)	X, W	11.5%	217-220℃
	LFM-14 (Sn-3.5Ag-0.7Cu)			217-218℃
SPM	LFM-48 (Sn-3.0Ag-0.5Cu)	X, W	11.0%	217-220℃
	LFM-14 (Sn-3.5Ag-0.7Cu)			217-218℃
MHS-32	LFM-31 (Sn-8.0Zn-3.0Bi)	X, W	12.0%	190-199℃
IBL	LFM-52 (Sn-3.5Ag-0.5Bi-3.0In)	X, W	11.0%	207-214℃
				194-206℃
INP	LFM-71 (Sn-3.5Ag-0.5Bi-4.0In)	X, W	11.0%	205-212℃
				139℃
A75	LFM-65 (Sn-58.0Bi)	X, W	12.0%	139℃

※LFM-48およびLFM-14はUS PAT No.5527628のサブライセンスを取得しています。※LFM-70はJP PAT No.3040929のライセンス粉末を使用しています。※LFM-52およびLFM-71はJP PAT No.2805595他のライセンス粉末を使用しています。※500g容器入りが標準です。シリンジ容器入りも対応しています。※粉末サイズは、U:10~28μm, X:25~45μm, W:20~38μmです。※製品によって在庫がない場合がありますので、営業担当までご相談ください。

Technology for the future

almit
日本アルミット株式会社

本社: 〒164-8666 東京都中野区弥生町2-14-2 アルミットビル TEL.03-3379-2277 FAX.03-3374-2593
大阪支店: 〒542-0081 大阪市中央区南船場3-6-28 第2声池ビル TEL.06-6252-5039 FAX.06-6252-5026
九州営業所: 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-3-11 KDX博多南ビル TEL.092-483-0367 FAX.092-483-0324
上海アルミット有限公司: 上海市嘉定区安亭镇国际汽车城高科技产业园嘉宝路香浦1号厂房201805 TEL.+86-21-3950-9808 FAX.+86-21-3950-9886
ALMIT (THAILAND) CO., LTD. (SALES OFFICE): 1702-1, 17TH FLOOR EXCHANGE TOWER 388 SUKHUMVIT ROAD KLONGTOEY, BANGKOK 10110 THAILAND TEL.+66-2-663-7080~1 FAX.+66-2-663-7082
中部アルミット工業: 〒460-0013 名古屋市中区上筒井1-4-10 シンブラタ生命ビル TEL.052-323-3971 FAX.052-323-3991